

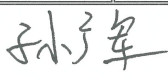

产能扩充的通知

客户名称	ALL	联系人	NA
------	-----	-----	----

受影响产品	商业名称	物料编码
	HC32L176KATA-LQ64	2L176KA0-0153A0SQ0T
	HC32L196KCTA-LQ64	2L196KC0-0153A0SQ0T
	HC32F176KATA-LQ64	2F176KA0-0153A0SQ0T
	HC32F196KCTA-LQ64	2F196KC0-0153A0SQ0T
	HC32L176KATA-LQ64	2L176KA0-0153A0SQ0T
	HC32L196KCTA-LQ64	2L196KC0-0153A0SQ0T
	HC32F176KATA-LQ64	2F176KA0-0153A0SQ0T
	HC32F196KCTA-LQ64	2F196KC0-0153A0SQ0T
	HC32F460KEUA-QFN60TR	2F460KE0-0104B2QB1R
	HC32F460PETB-LQFP100	2F460PE0-0104B2AQ1T
	HC32F460PCTB-LQFP100	2F460PC0-0104B2AQ1T
	HC32F460JETA-LQFP48	2F460JE0-0104B2SQ1T
	HC32F460JCTA-LQFP48	2F460JC0-0104B2SQ1T

变更原因描述	为应对 2021 年封装测试产能紧张，为保障对客户的供货，产能扩充通富微电子股份有限公司为第二供应商。									
变更方法描述	<p>供应商扩充</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>封装类型</th> <th>现有供应商</th> <th>扩充后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LQFP</td> <td>天水华天科技股份有限公司/ 星科金朋半导体有限公司</td> <td>天水华天科技股份有限公司/ 星科金朋半导体有限公司 及通富微电子股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>QFN</td> <td>西安华天科技股份有限公司</td> <td>西安华天科技股份有限公司 及通富微电子股份有限公司</td> </tr> </tbody> </table> <p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 三家封装供应商均为国内排名前三的供应商，为华大合格供应商。同时，华大有相同封装类型的产品在通富导入量产； 扩充至第二家供应商后，封装芯片外形尺寸无明显变化； 扩充至第二家供应商后，芯片表面印章第三行最后一位字母有变化，T 为天水华天/西安华天，N 为通富微电，C 为星科金朋，如下图： LQFP 产品扩产至第二家供应商通富微电，芯片表面的脱模孔（下图红框为例）有变化，不影响芯片的使用，如下图： 	封装类型	现有供应商	扩充后	LQFP	天水华天科技股份有限公司/ 星科金朋半导体有限公司	天水华天科技股份有限公司/ 星科金朋半导体有限公司 及通富微电子股份有限公司	QFN	西安华天科技股份有限公司	西安华天科技股份有限公司 及通富微电子股份有限公司
封装类型	现有供应商	扩充后								
LQFP	天水华天科技股份有限公司/ 星科金朋半导体有限公司	天水华天科技股份有限公司/ 星科金朋半导体有限公司 及通富微电子股份有限公司								
QFN	西安华天科技股份有限公司	西安华天科技股份有限公司 及通富微电子股份有限公司								

<p>原供应商</p> <p>表面 1 个孔（左上为 Pin1） 印章第三行最后一位字母为 T/C</p> 	<p>第二封装供应商（通富微电）</p> <p>表面 3 个孔（左上为 Pin1） 印章第三行最后一位字母为 N</p> 																
<p>5. 包装及标识没有变化；</p> <p>6. 变更验证计划如下：</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>待验证厂家</th> <th>计划验证完成时间</th> <th>样品准备完成时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HC32L176KATA/HC32L196KCTA HC32F176KATA/HC32F196KCTA HC32L176KATA/HC32L196KCTA HC32F176KATA/HC32F196KCTA (LQFP64 7*7 e=0.4)</td> <td>通富</td> <td>2021/10/29</td> <td>2021/8/16</td> </tr> <tr> <td>HC32F460KEUA-QFN60TR</td> <td>通富</td> <td>2021/11/30</td> <td>2021/11/1</td> </tr> <tr> <td>HC32F460PETB-LQFP100 HC32F460PCTB-LQFP100 HC32F460JETA-LQFP48 HC32F460JCTA-LQFP48</td> <td>通富</td> <td>2021/9/30</td> <td>2021/8/16</td> </tr> </tbody> </table>			待验证厂家	计划验证完成时间	样品准备完成时间	HC32L176KATA/HC32L196KCTA HC32F176KATA/HC32F196KCTA HC32L176KATA/HC32L196KCTA HC32F176KATA/HC32F196KCTA (LQFP64 7*7 e=0.4)	通富	2021/10/29	2021/8/16	HC32F460KEUA-QFN60TR	通富	2021/11/30	2021/11/1	HC32F460PETB-LQFP100 HC32F460PCTB-LQFP100 HC32F460JETA-LQFP48 HC32F460JCTA-LQFP48	通富	2021/9/30	2021/8/16
	待验证厂家	计划验证完成时间	样品准备完成时间														
HC32L176KATA/HC32L196KCTA HC32F176KATA/HC32F196KCTA HC32L176KATA/HC32L196KCTA HC32F176KATA/HC32F196KCTA (LQFP64 7*7 e=0.4)	通富	2021/10/29	2021/8/16														
HC32F460KEUA-QFN60TR	通富	2021/11/30	2021/11/1														
HC32F460PETB-LQFP100 HC32F460PCTB-LQFP100 HC32F460JETA-LQFP48 HC32F460JCTA-LQFP48	通富	2021/9/30	2021/8/16														
<p>7. 变更前在途、在库产品： 变更验证通过前涉及物料保持原供应商继续生产，销售接单不受影响。</p>																	
<p>变更生效日期或产品 Date Code 说明：从 2021 年 9 月 30 日开始按照验证计划陆续生效</p>																	

发行人	康超	发行日期	2021/4/28
华大半导体 MCU 事业部工程部经理签署： 		日期：2021. 9. 28 	

客户	部确认意见：
签署：	日期：

✎ 以上，特此通知，如果您有任何意见或建议，请随时与我司销售部门联系。✎